

# UVフルカットダイシングテープ

UV Tape for Full-cut Dicing

スミライト®FSL-Nシリーズ SUMILTE®FSL-N Series

## 特徴

Advantage

**低チップング**  
Less chipping

**ピックアップ特性**  
Excellent p/u property

**低チップ飛び**  
Less chipping flying

**耐ESD**  
ESD resistance

**薄ウェハ対応**  
Available for thin wafer

**薄ウェハ対応**  
Available for thin wafer

**極小チップ対応**  
Available for small dies

**パッケージ対応**  
Available for PKG sawing

## 技術トレンド

Technology Trend

半導体の小型化 チップ0.5mm角以下 チップ飛びを抑制  
Trend of smaller chip size -> below 0.5mm -> prevent chip flying

UV照射前の凝集力を強くすることで、チップング量の低減を実現  
By strengthen cohesion, chipping property can be enhanced.



チップ飛び多発 Chip flying

チップ飛び改善 Chip flying improved



チップング大 Big Chipping

チップング改善 Chipping improved

半導体の薄型化 厚み100μm以下 チップング性、ピックアップ性を向上  
Trend of thin wafer -> below 100um t -> Enhance chipping and P/U property

より軽剥離な粘着剤の設計により、ピックアップ性の向上を実現  
\* 100μm未満のチップ薄型化にも対応(FSL-N8000)  
\* Available for thin wafer/less than 100μm (FSL-N8000)

超薄ウェハ  
(ultra thin wafer)



## FSLシリーズ FSL series

### 製品紹介

品番 Grade	用途 Use	総厚(μm) Total Thickness	粘着力 (cN/25mm 対シリコン) Adhesion strength	基材 Face Material
N4000シリーズ	汎用グレード(General Grade)	90~110	UV前/Before UV : 300~350 UV後/After : 20~40	PVC、PO
N5000シリーズ	パッケージ用、樹脂基盤用 (For package & substrate sawing)	165~220	UV前/Before UV : 1200~1650 UV後/After : 35	
N6000シリーズ	異型チップ用(For rectangular chip)	90~110	UV前/Before UV : 100~250 UV後/After : 10~15	PVC、PO
N7000シリーズ	薄型チップ用(for thin chips) BGインラインマウント対応(correspond to BG-inline)	110	UV前/Before UV : 150 UV後/After : 10	PO
N8000シリーズ	超薄型チップ用(for ultra thin wafer) BGインラインマウント対応(correspond to BG-inline)	85	UV前/Before UV : 300 UV後/After : 7	PO

上記値は測定値であり保証値ではありません。

### 推奨シリーズ Recommendation series

チップング特性 Excellent Chipping	N4000 N6000、N7000 N8000 シリーズ	耐チップ飛び性 Excellent chip fly property	N4000 シリーズ
ピックアップ性 Excellent P/U property	N6000、N7000、N8000 シリーズ	糊付着特性 Less residue (PKG切断用) PKG sawing	N5000 シリーズ